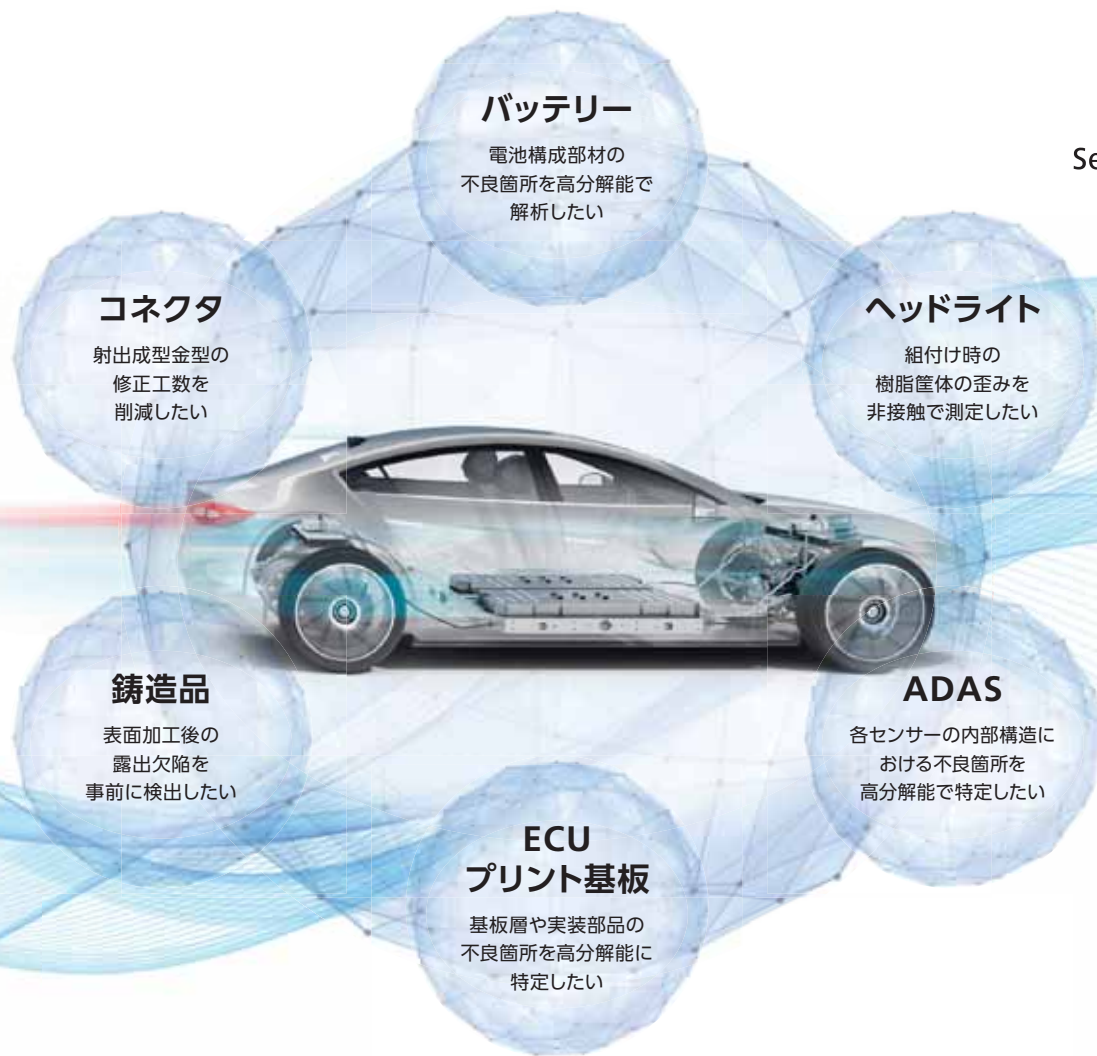




Seeing beyond



ZEISS 自動車部品検査解析ソリューション

検査の不正確さや遅延が、次工程に影響を与えていませんか？

新車開発の短期化、部品の複雑化が進む中、部品検査の精度がますます重要になっています。
 「ZEISS X線シリーズ」は、X線を利用して製品内部を観察する従来の手法に加えて、
 精度の高い寸法計測や独自の光学レンズを用いた超高解像度観察など多様な解析が可能です。
 見えないものを可視化する「ZEISS X線シリーズ」が、検査精度を高めスムーズな製造工程の実現に貢献します。

「ZEISS X線シリーズ」が、見えないものを可視化

**X線顕微鏡
「Xradia Versa」**

これまで物理解析で原因特定していたエレクトロニクス部品を非破壊・高分解能・短時間に解析



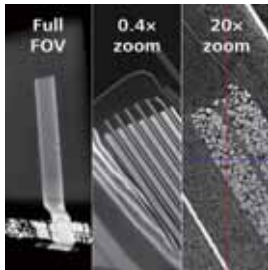
**計測用X線CT装置
「METROTOM」**

ドイツ工業規格VDI/VDEに準拠。大型ワークも短時間で撮像可能



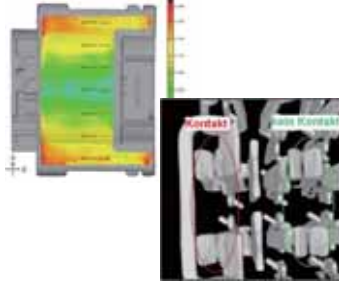
CASE STUDY

さまざまな自動車部品の精緻な計測・検査・解析に対応



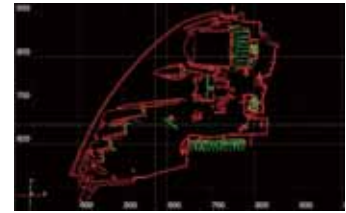
バッテリー

- X線顕微鏡「ZEISS Xradia Versa」: 正極・負極材の粒子構造解析
- X線CT装置「ZEISS METROTOM」: セル・モジュールの内部欠陥解析 (セル/モジュールのオーバーハング計測、異物混入、セルの欠陥、溶接部、電子部品品質、剥離、陽極のたわみ、筐体内部の欠陥)



コネクタ

- 筐体/組立品の寸法測定、空隙解析、CAD比較での肉厚・表面欠陥解析によるパラメータ調整の最適化
- CAD比較での肉厚・表面欠陥解析による射出成型パラメータ調整の最適化
- 組立品のピンの接続状況や内部欠陥、不良解析
- 射出成型金型の修正工数削減



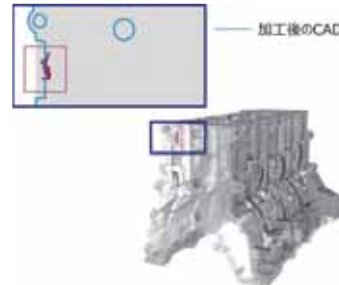
ヘッドライト

- アセンブリ状態での非破壊内部観察 (コネクタ部の異常、断線有無)
- 組付け時の樹脂筐体の歪みの非接触測定
- 形状/位置の検証を含む、コンポーネントの測定・解析



ECU/プリント基板

- サブミクロンの解像度でサンプルを傷つけず非破壊イメージング
- インターコネクタの3D非破壊不良解析、基盤構造のバーチャル断面解析



鋳造品

- 表面/内部欠陥の検査、製品の寸法計測
- アルミなど軽金属鋳造品はもちろんのこと、鉄のライナーの入った鋳物にも対応可
- ギガキャストの検査装置もラインナップ
- 属人性を排したAIによる自動欠陥検査
- CAE (湯流れ・凝固) 解析のフィードバック頻度を減らし早期に市場投入



ADAS

- コネクタ、レンズ鏡筒、レンズシステムの寸法測定
- ハウジングのシーリング、各コンポーネントの目視検査などの組立管理
- はんだ接合部やBGAなどのはんだ付けの解析
- MLCCなどの表面実装部品、ビアなどのプリント基板の外観検査

もっと詳しい情報は

かんたん資料請求シートより必要項目をチェックの上ぜひ資料をご請求ください。

「ZEISSが選ばれた理由」がわかるユーザー事例や比較表/製品カタログなどZEISS X線シリーズの詳しい資料をご用意しております。



Seeing beyond

カールツァイス株式会社
インダストリアルクオリティソリューションズ
〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-35-22
info.metrology.jp@zeiss.com http://www.zeiss.co.jp/imt

ZEISS X線
シリーズの
詳細はこちら

